

# Taller de Proyectos 1

12 dic 2025

## Grupo 4

<http://>

**Encargado del proyecto**

**Fechas de inicio y fin del proyecto**

16 sept 2025 - 23 ene 2026

**Progreso** 63%

**Tarea** 111

**Recursos** 6

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Especificación del proyecto	16/9/25	19/9/25
Definición de objetivos	16/9/25	19/9/25
Estudio sistema y planificación	16/9/25	19/9/25
Entrega 1	19/9/25	19/9/25
PCB0: Diseño electrónico y captura esquemática	22/9/25	13/10/25
Búsqueda de componentes	22/9/25	22/9/25
Posicionado componentes	23/9/25	29/9/25
Creación de nuevos componentes	30/9/25	6/10/25
Documentación esquemático. Control de cambios	7/10/25	9/10/25
Análisis consumo eléctrico	7/10/25	13/10/25
Análisis disipación de potencia	7/10/25	13/10/25
Rutado de conexiones	7/10/25	13/10/25
Generación de listado de materiales (BOM)	23/9/25	30/9/25
PCB1: Diseño electrónico y captura esquemática	22/9/25	13/10/25
Búsqueda de componentes	22/9/25	22/9/25
Posicionado componentes	23/9/25	29/9/25
Creación de nuevos componentes	30/9/25	6/10/25
Documentación esquemático. Control de cambios	7/10/25	9/10/25
Análisis consumo eléctrico	7/10/25	13/10/25
Análisis disipación de potencia	7/10/25	13/10/25
Rutado de conexiones	7/10/25	13/10/25
Generación de listado de materiales (BOM)	23/9/25	30/9/25

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PCB2: Diseño electrónico y captura esquemática	22/9/25	13/10/25
Búsqueda de componentes	22/9/25	22/9/25
Posicionado componentes	23/9/25	29/9/25
Creación de nuevos componentes	30/9/25	6/10/25
Documentación esquemático. Control de cambios	7/10/25	9/10/25
Análisis consumo eléctrico	7/10/25	13/10/25
Análisis disipación de potencia	7/10/25	13/10/25
Rutado de conexiones	7/10/25	13/10/25
Generación de listado de materiales (BOM)	23/9/25	30/9/25
PCB3: Diseño electrónico y captura esquemática	22/9/25	13/10/25
Búsqueda de componentes	22/9/25	22/9/25
Posicionado componentes	23/9/25	29/9/25
Creación de nuevos componentes	30/9/25	6/10/25
Documentación esquemático. Control de cambios	7/10/25	9/10/25
Análisis consumo eléctrico	7/10/25	13/10/25
Análisis disipación de potencia	7/10/25	13/10/25
Rutado de conexiones	7/10/25	13/10/25
Generación de listado de materiales (BOM)	23/9/25	30/9/25
Entrega 2	26/9/25	26/9/25
Entrega 3	3/10/25	3/10/25
Entrega 4	10/10/25	10/10/25

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PCB0: Diseño de la placa de circuito impreso	16/10/25	28/10/25
Creación de huellas de nuevos componentes	16/10/25	17/10/25
Posicionado de componentes	16/10/25	16/10/25
Definición de borde y zonas de conectores	16/10/25	16/10/25
Rutado de conexiones	17/10/25	17/10/25
Planos de disipación térmica	17/10/25	21/10/25
Planos de masa y otros	21/10/25	21/10/25
Documentación: serigrafía. Control de cambios	21/10/25	21/10/25
Documentación: acotaciones geométricas	24/10/25	24/10/25
Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	24/10/25	28/10/25
PCB1: Diseño de la placa de circuito impreso	16/10/25	28/10/25
Creación de huellas de nuevos componentes	16/10/25	17/10/25
Posicionado de componentes	16/10/25	16/10/25
Definición de borde y zonas de conectores	16/10/25	16/10/25
Rutado de conexiones	17/10/25	17/10/25
Planos de disipación térmica	17/10/25	21/10/25
Planos de masa y otros	21/10/25	21/10/25
Documentación: serigrafía. Control de cambios	21/10/25	21/10/25
Documentación: acotaciones geométricas	24/10/25	24/10/25
Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	24/10/25	28/10/25
PCB2: Diseño de la placa de circuito impreso	16/10/25	28/10/25
Creación de huellas de nuevos componentes	16/10/25	17/10/25
Posicionado de componentes	16/10/25	16/10/25

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Definición de borde y zonas de conectores	16/10/25	16/10/25
Rutado de conexiones	17/10/25	17/10/25
Planos de disipación térmica	17/10/25	21/10/25
Planos de masa y otros	21/10/25	21/10/25
Documentación: serigrafía. Control de cambios	21/10/25	21/10/25
Documentación: acotaciones geométricas	24/10/25	24/10/25
Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	24/10/25	28/10/25
PCB3: Diseño de la placa de circuito impreso	16/10/25	28/10/25
Creación de huellas de nuevos componentes	16/10/25	17/10/25
Posicionado de componentes	16/10/25	16/10/25
Definición de borde y zonas de conectores	16/10/25	16/10/25
Rutado de conexiones	17/10/25	17/10/25
Planos de disipación térmica	17/10/25	21/10/25
Planos de masa y otros	21/10/25	21/10/25
Documentación: serigrafía. Control de cambios	21/10/25	21/10/25
Documentación: acotaciones geométricas	24/10/25	24/10/25
Generación de ficheros para el fabricante (gerber)	24/10/25	28/10/25
Entrega 5	17/10/25	17/10/25
Entrega 6	24/10/25	24/10/25
Entrega 7	31/10/25	31/10/25
Entrega 8	7/11/25	7/11/25
Fabricación de la placa de circuito impreso	18/11/25	8/12/25

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Envío al fabricante	18/11/25	22/11/25
Recepción y Revisión	28/11/25	29/11/25
Montaje de componentes	2/12/25	8/12/25
Entrega 9	21/11/25	21/11/25
Entrega 10	28/11/25	28/11/25
Realización Firmware (uC/FPGA). Simulación y depuración	28/11/25	9/1/26
Control de elementos hardware: drivers	28/11/25	14/12/25
Verificación	16/12/25	18/12/25
Programa inicial. Especificaciones	2/12/25	18/12/25
Documentación firmware. Control de cambios	19/12/25	9/1/26
Entrega 11	5/12/25	5/12/25
Verificación hardware	9/12/25	19/12/25
Verificación inicial	9/12/25	9/12/25
Verificación firmware	10/12/25	12/12/25
Resolución de problemas	13/12/25	15/12/25
Ánalysis de prestaciones	16/12/25	18/12/25
Montaje final. Piezas mecánicas	19/12/25	19/12/25
Entrega 12	12/12/25	12/12/25
Entrega 13	19/12/25	19/12/25
Documentación	10/11/25	18/1/26

## Tarea

7

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Realización informe	10/11/25	18/1/26
Entrega 14	16/1/26	16/1/26
Fecha Entrega Final	23/1/26	23/1/26

## Recursos

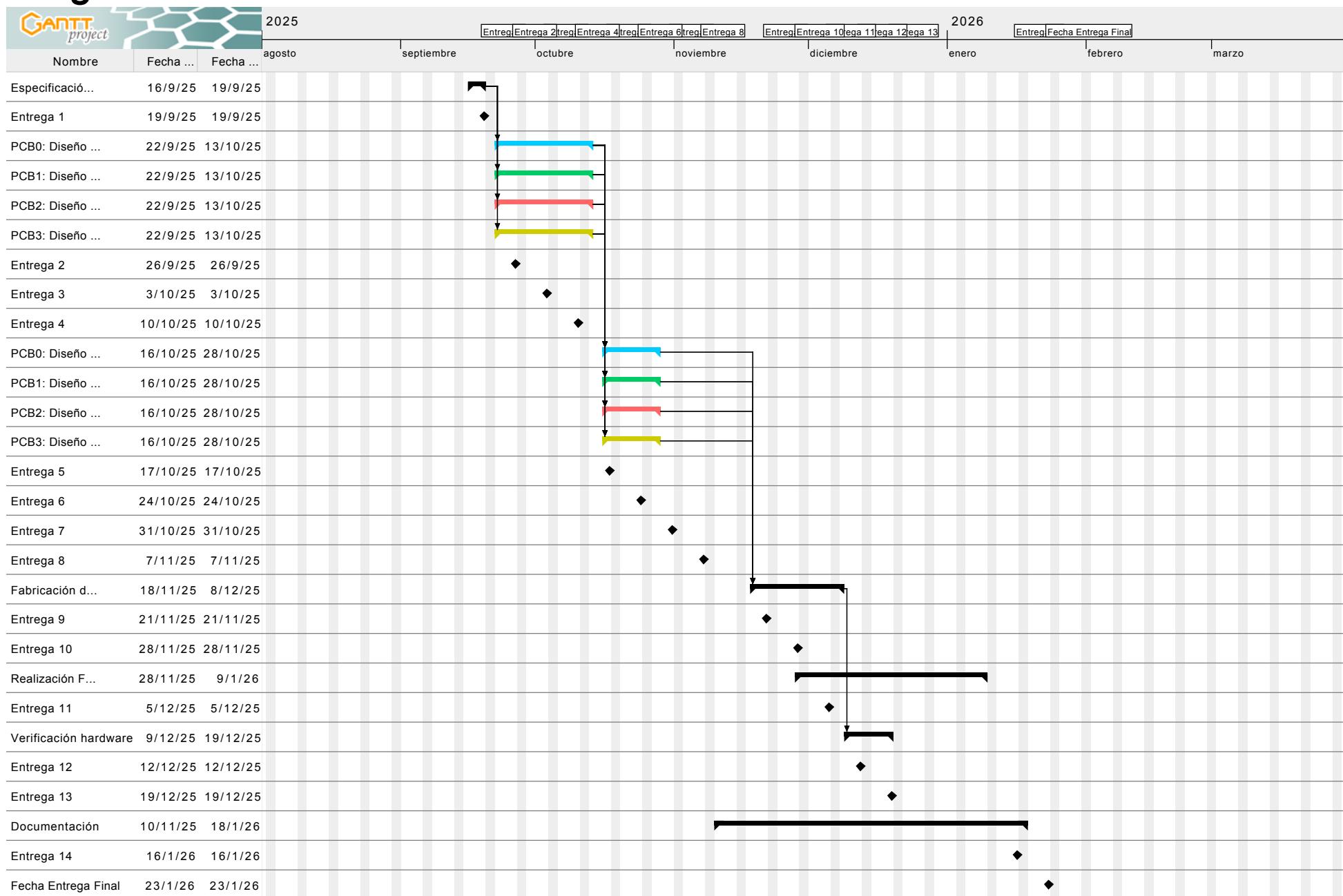
Nombre	Función
Alonso	Indefinido
Andrés	Indefinido
Iván	Indefinido
Lucía	Indefinido
Víctor	Indefinido
Supervisor de proyecto	Indefinido

# Taller de Proyectos 1

12 dic 2025

## Diagrama de Gantt

9



## Diagrama de recursos

